

# 壹、致股東報告書

於民國 111 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

時間過得真快，轉眼新的一年又來臨，敬祝大家虎年大吉大利，虎虎生風！

力成二年前開始執行的人才培育、傳承以及組織調整已經看到成效，得以將這一波人才流動、短缺及招募困難的衝擊降到最低。

同時我們積極進行的產品組合優化及先進技術的研發和製造也取得豐碩的成果。

在記憶體產品方面，西安廠與美光的服務合約到期，對集團營運已不構成影響。年初 Solidigm (SK Hynix 旗下子公司)的宣佈成立、獨立運作，雙方長期合作的夥伴關係將得以延續。鎧俠(Kioxia)雖然在二月公告其製程上有些問題，但很快的就恢復正常。整體而言，我們認為今年記憶體產品的營收穩定、每季營收持續成長的態勢不變。在邏輯產品方面，我們整體的表現非常傑出，超豐更是一枝獨秀，年營收成長 32.4 %，淨利成長 72.9%，力成母公司也不遑多讓，晶圓凸塊(Bumping)、覆晶芯片(Flip Chip-Chip Scale Package, FCCSP)、覆晶球陣列封裝(Flip Chip Ball Grid Array, FCBGA)、系統級封裝(SIP/SIM)及多顆晶片(dies)堆疊等產品的生產，提前達到預定的目標。

2021 年，力成集團在供應商、客戶夥伴的支持以及全體同仁的共同努力下，交出自公司創立以來最優異的成績，合併營收達到新台幣 837.94 億元，歸屬母公司的稅後淨利金額為新台幣 88.98 億元，每股盈餘(EPS)為 11.54 元。

展望新的年度，全球經濟正面臨民族主義的興起、區域地緣性的貿易衝突、俄烏戰爭、中美科技貿易戰及新冠肺炎疫情持續蔓延等諸多挑戰，遠距上班、上學等措施改變了人們工作、生活的作息模式；同時，也加速了 AI、5G 通訊、自駕車、低軌道衛星及元宇宙等先進科技的快速發展，而這些科技應用的實現，半導體產業擔任非常重要的角色，過去大家注意力比較集中在晶圓製造，殊不知沒有先進的封測產業，這些科技的應用是很難達成的。力成在先進封測技術的發展是與世界一流企業並駕齊驅的，未來我們將：

1. 更加大先進產品設計及製程技術的投資及提升，如

(1) 應用矽穿孔 (Through-Silicon Via, TSV) 技術於

-- 影像感測器 (CMOS Image Sensor, CIS)、

-- 高頻寬記憶體 (High Bandwidth Memory, HBM) 及

-- 生物科技 (Bio. Tech)；

(2)應用扇外型面板級封裝 (Fan-Out Panel Level Packaging, FOPLP) 技術於

--高效能運算 (High Performance Computing, HPC) 、

--擴增實境 (Augmented Reality, AR) 、

--人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 、

--物聯網 (Internet of Things, IoT)及

--智慧駕駛……等。

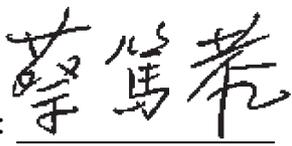
2.更專注於製造能力的提升，提供高可靠度、高品質的產品及服務。

3.更加強並提升應付世界變局的能力，成為客戶、供應商、員工及社會可靠的夥伴及力量。

4.持續推展ESG (環境、社會及公司治理)，落實企業永續發展的目標。

力成將朝「技術、品質及服務世界第一」的目標持續前進！

謝謝各位股東對力成集團全體員工及經營團隊的支持與鼓勵！

董事長：   
蔡篤恭

# 力成科技股份有限公司

## 一一〇年度營業報告書

### 一、110 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF) 111 年 1 月之「世界經濟展望」報告指出，110 年全球經濟成長率為 5.9%，較 109 年增加，顯示全球經濟正在持續復甦，然而受到新冠疫情再次爆發的影響，造成供應鏈中斷、勞工短缺、能源價格走高及物價上漲，影響了整體經濟的成長，已開發經濟體的經濟成長率將低於預期，在中國亦受到疫情擴散及限電措施等之影響，下半年經濟成長放緩，故 IMF 預測 111 年全球經濟成長率約為 4.4%。

在全球半導體的表現方面，根據國際研究暨顧問機構顧能(Gartner)調查結果顯示，宅經濟帶動電腦類與智慧型手機相關產品的需求熱潮，正在逐漸緩慢降溫並恢復到以往正常的成長動能，然而因半導體產品其他應用之需求成長而持續缺貨，預估全球半導體市場仍將會呈現正成長之態勢，總計 110 年全球半導體產品營收為美金 5,559 億元，較 109 年增加 26.2%。在台灣半導體產業表現方面則明顯優於全球，工研院產科國際所於 111 年 2 月統計 110 年台灣 IC 產業產值達新台幣 40,820 億元(美金 1,458 億元)，較 109 年成長 26.7%，其中 IC 封裝業為新台幣 4,354 億元，較 109 年成長 15.3%，IC 測試業為新台幣 2,030 億元，較 109 年成長 18.4%。

本公司亦受惠於宅經濟所帶動之市場需求，因為伺服器、筆記型電腦和行動終端產品等的需求提升，帶動整體業務成長，尤其在記憶體產品業務方面，110 年全年度營收及獲利表現較去年出現顯著的成長，並達成我們設定的預期目標。未來我們仍將採取持續深耕技術、提供優良品質與服務並擴充產能，以滿足客戶需求並取得客戶的信賴，透過整合集團資源等方式來提高經營效率及降低成本，並積極研發新技術、開發新產品線、投資新設備以及強化策略夥伴聯盟等方式，來增加公司整體的競爭力。

茲將本公司 110 年度的營運成果報告如下：

#### (一)110 年度營業實施情形

本公司 110 年度合併營收為新台幣 837 億 9 仟 4 佰萬元，較 109 年度的新台幣 761 億 8 仟 1 佰萬元成長 9.99%；在盈餘方面，110 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 88 億 9 仟 8 佰萬元，較 109 年度之淨利新台幣 66 億 6 仟 2 佰萬元成長 33.56%。

#### (二)財務收支情形

110 年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)

a.營業活動之現金淨流入	24,649,382 仟元
b.投資活動之現金淨流出	14,059,133 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	8,715,936 仟元
主要係配發股東現金股利及償還銀行借款	

### (三)獲利能力分析

分析項目		年度	110 年度	109 年度
獲利能力	營業利益 / 實收資本比率		186.42%	137.56%
	稅前純益 / 實收資本比率		188.74%	133.41%
	資產報酬率		10.48%	7.78%
	股東權益報酬率		19.27%	14.44%
	純益率		10.62%	8.75%
	每股純益		11.54 元	8.60 元

### (四)研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，110 年度研究及發展費用約為新台幣 24.43 億元，約占全年合併營收的 2.92%。在現有的記憶體及邏輯產品封測技術基礎下，積極開發先進封測及異質產品整合技術，包含銅柱凸塊(Copper Pillar Bump, CPB)、覆晶封裝(Flip Chip, FC)、系統級封裝(SiP/SiM)、晶圓級封裝(Wafer Level Package, WLP)、CMOS 影像感測器(CMOS Image Sensor)、2.5D/3D TSV 及扇外型面板級封裝(Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)等封裝技術，為客戶提供全方位的解決方案。隨著 5G 天線封裝(5G Antenna in Package, AiP)技術開發及射頻(Radio Frequency, RF)實驗室啟用，目前已可提供 5G 封裝產品的驗證；在 CMOS 影像感測器(CIS)方面，則運用矽穿孔(TSV)連接技術，提升影像顯示讀取速度，積極發展應用於醫療、監控及車用的晶圓級晶片尺寸封裝；扇外型面板級封裝(FOPLP)方面，更因應後摩爾定律時代在晶片微縮(Chip Scaling)製程的困難，積極與客戶密切進行相關產品的開發及驗證。

## 二、111 年度營業計劃概要

### (一)經營方針

1. 重承諾(Promise)、創新技術(Technology)及提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
2. 專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
3. 致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
4. 以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。
5. 整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
6. 培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

### (二)預期銷售數量

世界半導體貿易統計(The World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)預期 111 年全球半導體市場將持續成長，年增幅可以超過雙位數達 10.1%，銷售額可達 6,065 億美元。由工研院產科國際所的統計資料預估，111 年台灣 IC 產業產值年增率將成長優於全球平均值達到 17.7%，新台幣 4.8 兆元的產值，顯示全球及台灣的半導體產業環境將可望持續成長。

展望 111 年，隨著新興電子應用的興起，在人工智慧、5G、電動車與自駕車、資料中心、遠距教學、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品及各式行動裝置的新功能推陳出新，半導體應用的領域將日益寬廣，業界預期半導體接下來的黃金十年將可被預期。

COVID-19 仍是影響各終端市場的最大不確定因素，歷經過去兩年的疫情，疫苗施打的比率已經大幅提升，預期疫情對全球經濟的影響將日益消退。111 年將有機會逐漸回復到疫情前的生活型態。然而，地緣政治與全球貿易摩擦依然嚴峻，對整體經濟市場的影響仍待觀察。

預估今年各式產品的生產量，包括邏輯晶片封測，記憶體晶片封測及系統模組產品封測等，均將持續成長。

111 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 160 億顆
測試	約 100 億顆
晶圓級封裝	約 100 萬片
晶圓測試	約 290 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 1.5 億顆

### (三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短交期及降低運送成本。
- 2.維持記憶體產品封裝測試的市場領先地位
- 3.持續邏輯產品(Logic)業務之拓展，並積極拓展覆晶封裝(Flip Chip, FC)、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝(Wafer Level Package, WLP)、晶圓級測試(Chip Probing, CP)、矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝(TSV CIS)以及扇外型面板級封裝(Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)的業務成長。
- 4.進一步維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於產品的成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

